

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年7月14日(14.07.2022)



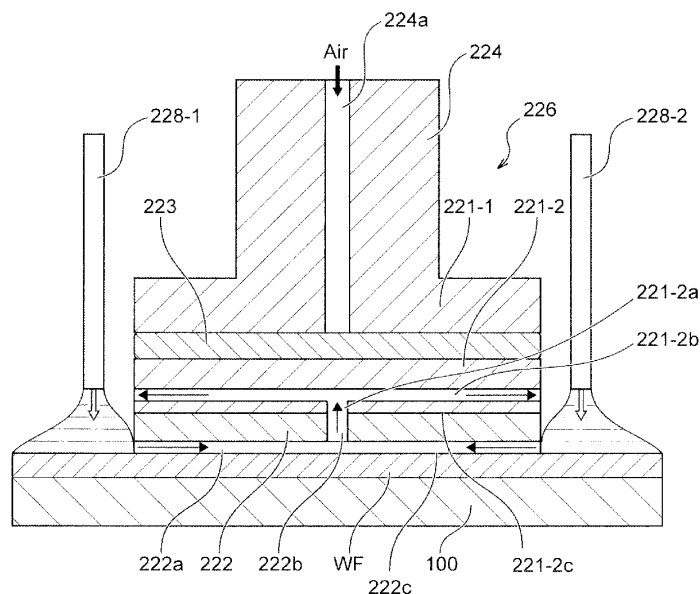
(10) 国際公開番号

WO 2022/149346 A1

- (51) 国際特許分類:
B24B 37/00 (2012.01) *H01L 21/304* (2006.01)
B24B 37/12 (2012.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2021/041139
- (22) 国際出願日: 2021年11月9日(09.11.2021)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2021-002158 2021年1月8日(08.01.2021) JP
- (71) 出願人: 株式会社荏原製作所 (EBARA CORPORATION) [JP/JP]; 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 大田 浩平(OTA, Kohei); 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社荏原製作所内 Tokyo (JP). ▲高▼田 暢行(TAKADA, Nobuyuki); 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社荏原製作所内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 宮前 徹, 外 (MIYAMAE, Toru et al.); 〒1000004 東京都千代田区大手町二丁目 2 番 1 号 新大手町ビル 2 0 6 区 ユアサハラ法律特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN,

(54) Title: SUBSTRATE PROCESSING APPARATUS AND SUBSTRATE PROCESSING METHOD

(54) 発明の名称: 基板処理装置および基板処理方法



(57) Abstract: The present invention minimizes scratching of a surface of a substrate that is being polished and improves the polishing rate. This substrate processing apparatus includes a table 100 for supporting a substrate WF, a pad holder 226 for holding a polishing pad 222 for polishing the substrate WF supported by the table 100, a nozzle 228 for supplying a polishing liquid to the periphery of the pad holder 226, and a pad rotation mechanism for rotating the pad holder 226. The pad holder 226 has a discharge hole 22a-2a formed in a central section of a holding surface 221-2c that holds the

[続葉有]



WO 2022/149346 A1

HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

polishing pad 222, and a discharge path 221-2b that allows communication from the discharge hole 221-2a to outside of the pad holder 226.

(57) 要約: 基板の被研磨面が傷つくのを抑制し、かつ、研磨レートを向上させる。基板処理装置は、基板WFを支持するためのテーブル100と、テーブル100に支持された基板WFを研磨するための研磨パッド222を保持するためのパッドホルダ226と、パッドホルダ226の周囲に研磨液を供給するためのノズル228と、パッドホルダ226を回転させるためのパッド回転機構と、を含み、パッドホルダ226は、研磨パッド222を保持する保持面221-2cの中央部に形成された排出穴221-2aと、排出穴221-2aからパッドホルダ226の外部に連通する排出路221-2bと、を有する。